

Verbundprojekt: Energiesparende und vertrauenswürdige Höchstfrequenzelektronik aus Europa - BEYOND5 -; Teilvorhaben: COP- freier Basewafer für HF FDSOI Bauelemente

Laufzeit: 01.06.2020 - 31.05.2023 Förderkennzeichen: 16MEE0060

Koordinator: Siltronic AG

Das übergreifende Ziel von BEYOND5 ist der Aufbau einer vollständig europäischen Zulieferkette für Radiofrequenzelektronik, basierend auf der europäischen SOI Technologieplattform, die neue HF-Anwendungsdomänen für Sensorik, Kommunikation, 5G-Funkinfrastruktur und darüber hinaus ermöglicht. BEYOND5 ist in erster Linie ein Technologieprojekt, an dem die wichtigsten europäischen Akteure mitwirken. Das Projekt deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Materialien, Halbleitertechnologien, Designs und Komponenten bis hin zu den Systemen ab. Im Rahmen dieses europäischen Verbundprojektes wird Siltronic einen neuen 300mm Basewafer für die 22FDX Technologie von Globalfoundries entwickeln, der die Hochfrequenz-Leistungsfähigkeit der 22FDX Bauelemente verbessert und damit die anvisierte Verwendung der Technologie im Bereich der 5G Kommunikation und Automobilradar unterstützt. Neben der Steigerung der HF Performance der 300mm Basewafer ist die wirtschaftliche Herstellung dieser speziellen Wafersubstrate eine wichtige Zielsetzung. Die globale Vermarktung von 300mm Siliziumsubstrate für die SOI Technologien kann mit diesem Projekt forciert und ausgeweitet werden mit dem Ziel, die erreichte Position von Siltronic in diesem Markt auszubauen.

Verbund: Energiesparende und vertrauenswürdige Höchstfrequenzelektronik aus Europa

Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Redaktion: DLR Projektträger

Länder / Organisationen: Belgien, Schweiz, Frankreich, Israel, Niederlande, Polen, Rumänien, Schweden, Türkei

Themen: Förderung, Information u. Kommunikation

[Zurück](#)

Weitere Informationen